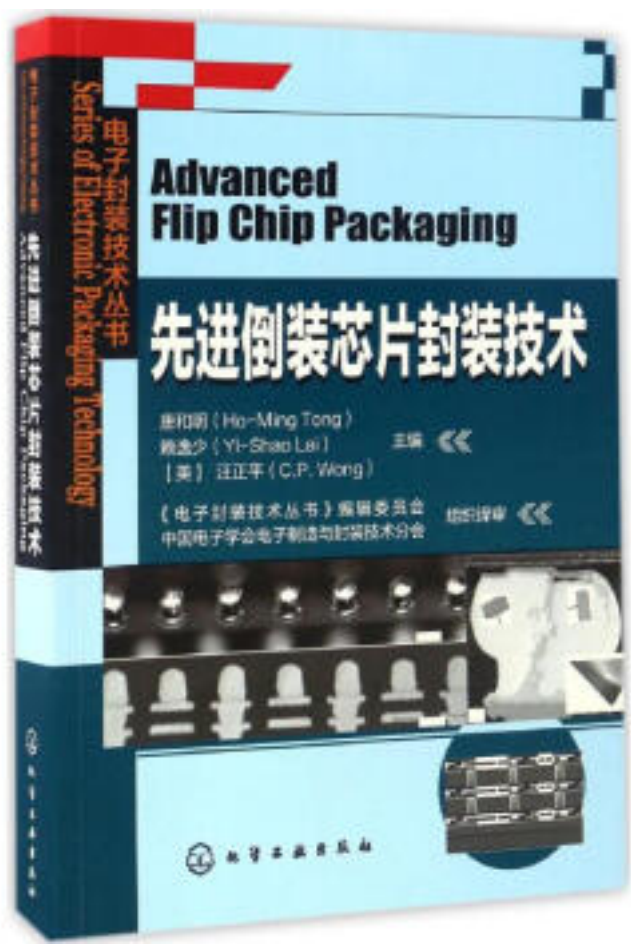


先进倒装芯片封装技术



[先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)

著者:唐和明（Ho-MingTong），赖逸少(Yi-S 著

[先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)

标签

评论

[先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)

书评

[先进倒装芯片封装技术_下载链接1](#)